

2008-2009年中国半导体材料行业市场分析研究咨 询报告

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《2008-2009年中国半导体材料行业市场分析研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/77357735.html>

报告价格：电子版: 6800元 纸介版：7300元 电子和纸介版: 7800

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【英文版价】 15000元

【英文电子】 16000元

【英文两版】 17000元

内容简介

随着以消费者为导向的应用爆炸式增长，半导体产业受到了极大驱动。半导体制造与封装越来越多地引入各种新材料，这为半导体材料供应商带来了许多商机。预测2008年全球半导体产业将增长4%，而全球半导体材料市场将增长9%，达461亿美元。在区域市场部分,日本在雄厚的晶圆制造和封装市场基础下，2008年以22%的占有率成为全球最大的材料市场,而台湾在过去四年晶圆和封装产业强劲成长的带动下,则成为第二大半导体材料市场。此外,总括新加坡、马来西亚、菲律宾、其它东南亚国家,以及小型全球市场则排名第三大。而大家关注的中国市场,在产能陆续开出之后,成为全球成长最快的半导体材料市场。

然而，目前我国半导体支撑材料业的发展很不平衡，与国际高科技产品相比较还存在一些差距。因此，国内半导体材料企业应该"苦练内功、夯实基础"，不断提高工艺水平，加强技术创新力度，让产品上档次，满足高端市场的需求。这样才不会忧虑国外厂商大举进入带来的激烈竞争，更不用担心国外先进技术带来的巨大冲击，反而可以吸引更多的大型厂商进入国内市场，形成一种良好的竞争机制与环境，促进半导体材料市场的健康发展以及国内电子信息产业企业的技术进步与产业升级。与半导体产业链上其他环节相比，国家对半导体材料产业的支持相对较弱，业界在不断呼吁，相关政策应尽快延伸到材料业。

在消费电子与绿色能源需求的推动下，新型半导体材料将更多地在生产中得到应用，新材料的使用同时也是降低成本的需求。此外，新的工艺技术也会对材料提出新的要求。预计到2010年或2014年，硅材料的技术和产业发展将走向极限，第二代和第三代半导体技术和产业将成为研究和发展的重点。政府决策部门、半导体科研单位和企业现有的技术、市场和发展趋势面前应把握历史机遇，迎接挑战。

本报告对国内外半导体材料行业的发展状况进行了深入透彻地研究，对我国半导体材料主要市场发展情况、投资机会作了详尽分析。报告重点分析了下游半导体行业发展情况，报告还对国内重点半导体材料企业及未来半导体材料发展趋势进行了分析，是半导体材料及相关制造企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握半导体材料行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

报告目录

目录

第一章 半导体材料概述	1
第一节 半导体材料的概述	1
一、半导体材料的定义	1
二、半导体材料的分类	2
三、半导体材料的特点	3
四、化合物半导体材料介绍	4
第二节 半导体材料特性和制备	6
一、半导体材料特性和参数	6
二、半导体材料制备	7
第二章 世界半导体材料市场概况	9
第一节 世界总体市场概况	9
一、全球半导体材料的进展分析	9
二、全球半导体材料市场发展现状	11
三、第二代半导体材料砷化镓发展概况	12
四、第三代半导体材料GaN发展概况	13
第二节 北美半导体材料发展分析	14
一、北美半导体设备与材料市场	14
二、美国新半导体材料开发分析	16
三、美国道康宁在半导体材料方面的研究进展	17
四、2011年美国半导体材料市场发展预测	19
第三节 亚洲半导体材料发展	20
一、日本半导体新材料分析	20
二、韩国半导体材料产业分析	20
三、台湾半导体材料市场分析	22
第四节 世界半导体材料行业发展趋势	23
一、世界半导体材料发展趋势	23
二、2008年全球半导体材料市场分析	30
三、2011年世界半导体封装材料发展预测	31
第三章 中国半导体材料行业概况	33
第一节 行业发展概况	33
一、半导体材料的发展概况	33
二、半导体封装材料行业分析	36
三、半导体硅材料发展现状	44

四、国内半导体材料创新发展分析	46
五、半导体支撑材料发展瓶颈分析	49
第二节 中国半导体材料进出口状况	53
一、2008年半导体材料进口分析	53
二、2008年半导体材料出口分析	55
第三节 半导体材料技术发展分析	57
一、新材料研发投入分析	58
二、最大半导体材料市场分析	58
三、新材料与新工艺需求分析	59
四、半导体材料竞争无线应用领域	60
五、SOI技术发展分析	64
第四节 半导体材料技术动向及挑战	67
一、铜导线材料	67
二、硅绝缘材料	69
三、低介电质材料	69
四、高介电质、应变硅	70
五、太阳能板	71
六、无线射频	71
七、发光二极管	72
第四章 主要半导体材料发展概况	75
第一节 硅晶体	75
一、国内外多晶硅产业概况	75
二、单晶硅和外延片发展概况	82
三、中国硅晶体材料产业特点	84
四、我国多晶硅产业发展现状分析	85
五、2009-2010年多晶硅行业发展趋势	88
第二节 砷化镓	90
一、砷化镓产业发展概况	90
二、砷化镓材料发展概况	95
三、我国砷化镓产业链发展情况分析	97
四、砷化镓产业需求分析	99
第三节 GaN	100
一、GaN材料的特性与应用	100
二、GaN的应用前景	106
三、GaN市场发展现状	106

四、GaN产业市场投资前景 107

第四节 碳化硅 109

一、碳化硅概况 109

二、碳化硅生产企业分析 110

三、国内碳化硅晶体发展情况 113

四、2008-2010年碳化硅市场发展趋势 115

第五节 其他半导体材料 117

一、非晶半导体材料概况 117

二、宽禁带氮化镓材料发展概况 119

三、可印式氧化物半导体材料技术发展 123

第五章 半导体行业发展情况 131

第一节 国内外半导体产业发展情况 131

一、国内外半导体产业发展概况 131

二、中国内地半导体产业发展环境分析 135

三、2008年全球半导体行业发展态势分析 144

四、半导体企业竞争策略 157

五、2008年奥运会后的世界半导体市场 159

第二节 半导体市场发展预测 162

一、2008年中国半导体市场增长预测 162

二、2009年半导体产业发展预测 164

三、2008-2010年半导体产业预测 165

第六章 主要半导体市场发展概况 168

第一节 LED产业发展 168

一、全球LED产业发展概况 168

二、中国LED产业发展概况 192

三、我国半导体照明市场应用情况 206

四、2008年LED产业资源整合分析 211

五、2008-2010年中国LED产业发展预测 214

第二节 电子元器件市场 217

一、我国电子元器件产业发展前景分析 217

二、电子元件产业升级分析 221

三、2008年电子元器件收入利润分析 224

四、2008年电子元器件市场渠道供应趋势分析 225

五、2010年电子元器件市场预测 232

第三节 集成电路 232

- 一、2008年半导体集成电路产量分析 232
- 二、2008年中国集成电路市场运行分析 238
- 三、2010年集成电路产业的总体发展趋势 242
- 四、2011年我国集成电路市场规模预测 243
- 五、未来集成电路技术发展趋势 244
- 第四节 半导体分立器件 246
 - 一、2008年半导体分立器件产量分析 246
 - 二、2008年半导体器件进出口分析 253
 - 三、2008年半导体分立器件市场发展态势 254
 - 四、2008年半导体分立器件市场预测 254
- 第五节 其他半导体市场 258
 - 一、半导体气体与化学品产业发展概况 258
 - 二、IC光罩市场发展概况 259
- 第七章 半导体材料主要生产商简介 261
 - 第一节 有研半导体材料股份有限公司 261
 - 一、公司概况 261
 - 二、2008年公司经营情况 263
 - 三、2008年公司动态 269
 - 第二节 天津中环半导体股份有限公司 271
 - 一、公司概况 271
 - 二、2008年公司经营情况 272
 - 三、2008年公司动态 278
 - 第三节 峨嵋半导体材料厂 281
 - 一、公司概况 281
 - 二、公司发展成就 282
 - 第四节 四川新光硅业科技有限责任公司 286
 - 一、公司概况 286
 - 二、2008年公司动态 288
 - 第五节 洛阳中硅高科技有限公司 288
 - 一、公司概况 288
 - 二、公司技术研发分析 290
 - 第六节 宁波立立电子股份有限公司 291
 - 一、公司概况 291
 - 二、公司产品及技术研发 292
 - 三、2008年公司动态 293

第七节 宁波康强电子股份有限公司 294

一、公司概况 294

二、2008年公司经营情况 295

第八节 南京国盛电子有限公司 298

一、公司概况 298

二、工艺技术与产品 299

第八章 半导体材料发展趋势 301

第一节 半导体材料发展预测 301

一、2008-2009年全球半导体材料市场成长率预测 301

二、2009-2010年化合物半导体材料市场预测 304

三、2010年中国半导体材料产业发展前景 304

四、2010年半导体材料销售额预测 305

五、未来半导体材料发展趋势 308

第二节 主要半导体材料的发展趋势 309

一、硅材料 309

二、GaAs和InP单晶材料 310

三、半导体超晶格、量子阱材料 310

四、一维量子线、零维量子点半导体微结构材料 313

五、宽带隙半导体材料 314

六、光子晶体 316

七、量子比特构建与材料 316

第九章 半导体材料投资及建议 318

第一节 半导体材料投资市场分析 318

一、国内企业投资多晶硅形势分析 318

二、2008年全球半导体投资市场分析 320

三、半导体产业投资模式变革分析 321

四、半导体领域风险投资困境分析 324

五、半导体新材料表征面临的挑战 324

六、半导体玻璃应用前景分析 330

第二节 2008年中国半导体行业投资分析 332

一、2008年中国半导体投资风险 332

二、2008年中国半导体业机会 332

三、2008-2009年中国半导体投资预测 333

第三节 发展我国半导体材料的建议 334

一、硅单晶和外延材料 334

二、GaAs及其有关化合物半导体单晶材料发展建议 334

三、发展超晶格、零维半导体微结构材料建议 334

图表目录

图表：元素半导体的性质与结构 4

图表： - 化合物半导体的性质 5

图表： - 化合物半导体的性质 5

图表：部分二元化合物半导体的性质 5

图表：CZT薄膜的能隙 E_g 与组分的关系 6

图表：半导体用材料的定义及范围 9

图表：2006-2009年全球电子级硅片总消耗量预测 10

图表：2006-2008年管芯制造材料预测 11

图表：2005年全球半导体材料市场规模 11

图表：2008-2009年全球半导体材料市场规模预测 15

图表：2000-2007年全球Fab产能分布的变化 23

图表：2007年半导体材料市场分布统计 24

图表：High-k/metalgate材料技术的演进发展 25

图表：Dualmetal与Dualhigh-k的比较 26

图表：藉由电极矩改变Gate的功函数 28

图表：在金属闸极中添加不纯物 28

图表：主要半导体材料的比较 34

图表：半导体材料的主要用途 35

图表：2001-2005年中国半导体封装材料市场规模及增长 36

图表：2005年中国半导体封装材料市场结构 37

图表：2005年国内半导体引线框架制造企业产能分布及市场份额 39

图表：2005年国内金丝生产企业市场份额 40

图表：现代微电子工业对硅片关键参数的要求 46

图表：2008年1月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53

图表：2008年2月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53

图表：2008年3月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53

图表：2008年1季度全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53

图表：2008年4月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54

图表：2008年5月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54

图表：2008年6月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54

图表：2008年2季度全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54

- 图表：2008年7月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54
- 图表：2008年8月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 55
- 图表：2008年1-8月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 55
- 图表：2008年1月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 55
- 图表：2008年2月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 55
- 图表：2008年3月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 55
- 图表：2008年1季度全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
- 图表：2008年4月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
- 图表：2008年5月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
- 图表：2008年6月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
- 图表：2008年2季度全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
- 图表：2008年7月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 57
- 图表：2008年8月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 57
- 图表：2008年1-8月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 57
- 图表：1998年IBM公司使用自有的CMOS7S制程技术来产制的芯片 68
- 图表：High-k材料与SiO₂材料比较 70
- 图表：德国西门子公司用单晶硅材料制成的太阳能基板 71
- 图表：常见的LED发光材料 72
- 图表：红光LED的照射使植物（农作物）增长图 73
- 图表：2002-2010年全球及中国太阳能级多晶硅需求量统计及预测 76
- 图表：2005-2010年全球太阳能电池产量统计与预测 77
- 图表：2005年世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况 78
- 图表：2003-2006年国内多晶硅生产产量趋势图 79
- 图表：多晶硅质量指标 81
- 图表：砷化镓与硅的组件特性比较 90
- 图表：砷化镓微波三种元件结构之特性的比较 91
- 图表：砷化镓产业上下游关联图 93
- 图表：砷化镓微波组件的商业运用 94
- 图表：GaAs单晶生产方法比较 95
- 图表：世界GaAs单晶主要生产厂家 96
- 图表：钐矿GaN和闪锌矿GaN的特性 100
- 图表：双气流MOCVD生长GaN装置 103
- 图表：GaN基器件与GaAs及SiC器件的性能比较 104
- 图表：以发光效率为标志的LED发展历程 104
- 图表：不同碳化硅类型情况简介 109

- 图表：碳化硅晶片生产及应用前景情况 110
- 图表：碳化硅晶片生产企业情况 111
- 图表：碳化硅晶片生产工艺 112
- 图表：SiC器件的研究概表 120
- 图表：非晶型氧化镉镓锌材料系统组成比例(右)与电子迁移率(左) 124
- 图表：五种基本的印制方式 125
- 图表：典型传统印制技术应用之基材种类与印制材料及其最小线宽 126
- 图表：软式微影技术的组件制作流程 127
- 图表：高分辨率软式微影技术压印头印制250nm×250nm方柱图 128
- 图表：由100 μ m玻璃背板及30 μ m聚合物双层模块成具有270nm图案之压印头实例 128
- 图表：传统印制技术与软式微影技术相对应的比较 129
- 图表：全球半导体应用领域分布 131
- 图表：2005年全球半导体分类产品销售收入 132
- 图表：2006年排名前十位的半导体公司 132
- 图表：2003-2005年半导体市场向亚太地区转移 133
- 图表：我国集成电路生产线统计 138
- 图表：2006年我国内地IC封装测试企业收入前十名 139
- 图表：2008年6月全球半导体销售情况 145
- 图表：2000-2008年欧洲半导体月度销售额 145
- 图表：2000-2008年欧洲半导体各月销售额同比增长率 146
- 图表：2007年7月-2008年7月全球半导体销售额 146
- 图表：2007年7月-2008年7月全球半导体销售额同比和环比变化率 147
- 图表：2007年7月-2008年7月欧洲半导体销售额 147
- 图表：2007年7月-2008年7月欧洲半导体销售额同比和环比变化率 147
- 图表：2007年7月-2008年7月美国半导体销售额 148
- 图表：2007年7月-2008年7月美国半导体销售额同比和环比变化率 148
- 图表：2007年7月-2008年7月日本半导体销售额 149
- 图表：2007年7月-2008年7月日本半导体销售额同比和环比变化率 149
- 图表：2007年7月-2008年7月亚太地区半导体销售额 149
- 图表：2007年7月-2008年7月亚太地区半导体销售额同比和环比变化率 150
- 图表：2008年3-7月中国半导体销售额 150
- 图表：2007年8月-2008年8月全球半导体销售额 151
- 图表：2007年8月-2008年8月全球半导体销售额同比和环比变化率 151
- 图表：2007年8月-2008年8月欧洲半导体销售额 152
- 图表：2007年8月-2008年8月欧洲半导体销售额同比和环比变化率 152

- 图表：2007年8月-2008年8月美国半导体销售额 152
- 图表：2007年8月-2008年8月美国半导体销售额同比和环比变化率 153
- 图表：2007年8月-2008年8月日本半导体销售额 153
- 图表：2007年8月-2008年8月日本半导体销售额同比和环比变化率 153
- 图表：2007年8月-2008年8月亚太地区半导体销售额 154
- 图表：2007年8月-2008年8月亚太地区半导体销售额同比和环比变化率 154
- 图表：2008年3-8月中国半导体销售额 155
- 图表：2008年上半年半导体行业销售额排名 156
- 图表：2008年上半年半导体行业销售额增长率排名 156
- 图表：2008-2012年中国半导体市场营业收入预测 162
- 图表：2008-2012年在中国设计的主要电子产品的营业收入预测 163
- 图表：全球主要LED业者概况 169
- 图表：2011年全球LED市场成长预测 169
- 图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售额统计） 170
- 图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售量统计） 170
- 图表：全球主要LED领先厂商 175
- 图表：2006年全球主要LED大厂营运收入 175
- 图表：LED产业链投资规模估算 176
- 图表：国际半导体照明专利状况对比 176
- 图表：全球七大LED巨头专利数分布 176
- 图表：LED发光效率演进 185
- 图表：各种照明技术发光效率与光电转换效率变化 186
- 图表：LED基本分类与应用市场 188
- 图表：传统亮度与高亮度LED产品应用市场 189
- 图表：2006-2010年全球手机出货量预测 190
- 图表：各种手机用面板技术比较 191
- 图表：2006-2010LED背光模组出货趋势 191
- 图表：2003-2009年全球照明市场规模及预测 191
- 图表：2004-2006年蓝光LED芯片价格变化 192
- 图表：LED应用市场发展路线图 192
- 图表：2006年国内LED芯片市场分布图 194
- 图表：2008年全球LED应用领域分布情况 212
- 图表：国内主要LED产业基地及其核心企业 213
- 图表：2003-2010年国内GaN芯片产能发展预测 213
- 图表：国内LED产品的应用领域分布 213

- 图表：我国半导体照明产业中下游优劣势比较 214
- 图表：2008年的中国地区电子元器件市场业务平均增长幅度预测 225
- 图表：2008年元器件原厂的平均交货期有所缩短 228
- 图表：2008年电子元器件独立分销商开始将重点转向服务的提供 230
- 图表：电子元器件分销商提供小批量供应时所面临的主要挑战 231
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路全国产量合计 232
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路北京市产量合计 233
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路天津市产量合计 233
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路河北省产量合计 233
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路辽宁省产量合计 234
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路上海市产量合计 234
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路江苏省产量合计 234
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路浙江省产量合计 235
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路福建省产量合计 235
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路山东省产量合计 235
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路河南省产量合计 236
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路湖北省产量合计 236
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路湖南省产量合计 236
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路广东省产量合计 237
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路重庆市产量合计 237
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路四川省产量合计 237
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路贵州省产量合计 238
- 图表：2008年2-8月半导体集成电路甘肃省产量合计 238
- 图表：2004-2008年上半年中国集成电路市场销售额规模及增长率 239
- 图表：2008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率 240
- 图表：2008年上半年中国集成电路市场应用结构 240
- 图表：2008年上半年中国集成电路市场产品结构 241
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件全国产量合计 246
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件北京市产量合计 246
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件天津市产量合计 247
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件河北省产量合计 247
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件辽宁省产量合计 247
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件吉林省产量合计 248
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件黑龙江产量合计 248
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件上海市产量合计 248

- 图表：2008年2-8月半导体分立器件江苏省产量合计 249
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件浙江省产量合计 249
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件安徽省产量合计 249
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件福建省产量合计 250
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件江西省产量合计 250
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件山东省产量合计 250
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件河南省产量合计 251
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件湖北省产量合计 251
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件湖南省产量合计 251
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件广东省产量合计 252
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件广西区产量合计 252
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件四川省产量合计 252
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件贵州省产量合计 253
- 图表：2008年2-8月半导体分立器件陕西省产量合计 253
- 图表：2008年全球分立器件终端产品市场预测 255
- 图表：2008年我国分立器件市场按产品结构细分预测 255
- 图表：半导体气体与化学品技术发展蓝图 259
- 图表：有研半导体材料股份有限公司200mm硅抛光片规格 262
- 图表：有研半导体材料股份有限公司150mm硅抛光片规格 262
- 图表：2008年2季度有研半导体材料股份有限公司主营构成表 264
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司每股指标 264
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司获利能力表 264
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司经营能力表 265
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司偿债能力表 265
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司资本结构表 265
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司发展能力表 265
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司现金流量分析表 266
- 图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司利润分配表 266
- 图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司资产负债表 267
- 图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司现金流量表 268
- 图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司利润表 268
- 图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司财务指标 269
- 图表：天津中环半导体股份有限公司产品销售市场 271
- 图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司收入情况 273
- 图表：2008年2季度天津中环半导体股份有限公司主营构成表 274

- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司每股指标 274
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司获利能力表 274
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司经营能力表 275
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司偿债能力表 275
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司资本结构表 275
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司发展能力表 275
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司现金流量分析表 276
- 图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司利润分配表 276
- 图表：2006-2009年天津中环半导体股份有限公司项目进度 277
- 图表：2008-2009年天津中环半导体股份有限公司利润表 277
- 图表：2008-2010年天津中环半导体股份有限公司基本财务状况 278
- 图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司分业务情况 279
- 图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司各项业务的经营情况 280
- 图表：2008年天津中环半导体股份有限公司业绩越来越多的依赖单晶硅 280
- 图表：天津中环半导体股份有限公司未来区熔单晶硅业务增长敏感性分析 281
- 图表：新光硅业公司股东及持股比例 287
- 图表：立立电子抛光片产品规格 292
- 图表：立立电子外延片产品规格 293
- 图表：2008年2季度宁波康强电子股份有限公司主营构成表 295
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司每股指标 295
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司获利能力表 296
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司经营能力表 296
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司偿债能力表 296
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司资本结构表 296
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司发展能力表 297
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司现金流量分析表 297
- 图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司利润分配表 297
- 图表：2008年全球半导体材料市场规模 302
- 图表：中国半导体材料需求量 305
- 图表：2005-2006年我国多晶硅企业筹建、新建、扩建情况 318
- 略.....

(如需详细目录, 请来电索取)

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/77357735.html>